

Technavio Research によると、半導体マイクロコンポーネント市場は、2023～2028 年にかけて CAGR 4.38%で成長すると予想されている。この期間中、市場は 308 億米ドルの成長を示すと予想されている。

急速に進化するテクノロジー環境において、モノのインターネット (IoT) は重要なトレンドであり、様々な家電製品やデバイスをインターネットに接続している。この相互接続されたデバイスのネットワークには、自動車、テレビ、ラップトップ、コーヒーメーカー、自動ドアロック、GPS 対応ペットトラッカー、ウェアラブルデバイス、携帯電話が含まれる。4G などの高速無線インターネット接続が普及し、Wi-Fi や GPS 対応スマートフォンの大量生産と需要が高まるにつれ、正確でリアルタイムな情報に対するニーズが高まっている。この需要により、モバイル環境で必要な限られた時間枠で正確なデータを計算および取得できる、より高度なデジタル信号プロセッサ (DSPs) が必要になった。

研究分析の概要

半導体マイクロコンポーネント市場は、様々な業界で小型化、エネルギー効率が高く、複雑な半導体デバイスに対する需要が高まっているため、大幅な成長を遂げている。しかし、この市場は、半導体セキュリティの脆弱性、価格圧力による利益率の圧力、高度な半導体マイクロコンポーネントの製造と設計の複雑さなど、いくつかの障害にも直面している。Analog Devices のような半導体メーカーは、これらの課題に対処するために R&D に多額の投資を行っている。例えば、携帯電話、ノートパソコン、スマートフォン、GPS 対応ペットトラッカー、コーヒーメーカー、自動ドアロック、ウェアラブルデバイスなどのコンシューマエレクトロニクスにとって不可欠なエネルギー効率に注力している。さらに、半導体マイクロコンポーネントへの人工知能 (AI) の統合は増加傾向にあり、自動車エレ

外ロニクス、テレコム、エレクトロニクスに応用されている。ただし、脆弱性は重大なリスクや結果につながる可能性があるため、半導体業界は半導体セキュリティの課題にも対処する必要がある。全体として、半導体マイクロコンポーネント市場は、高度でエネルギー効率の高い半導体デバイスに対する需要の増加により、成長軌道を続けると予想される。

市場調査の概要

半導体マイクロコンポーネント市場には、メモリ、ロジック、アナログ、マイクロコンポーネント、オプトエレクトロニクス、センサ、ディスクリート半導体を製造する集積回路（IC）メーカーなど、様々なプレーヤーが参加している。Technavio の市場分析によると、世界の半導体市場規模は、相手先商標供給メーカー（OEMs）および相手先商標設計製造業者（ODMs）への半導体 IC の出荷から生み出される収益によって決まる。この収益は、ファブ企業とファブレス企業の両方、および統合デバイスメーカー（IDMs）から得られている。世界の半導体市場の主な成長原動力には、半導体製造部門の大幅な拡大を反映した、新しい製造工場（ファブ）の建設と既存施設の拡張への多額の投資が含まれる。業界は、顧客エンゲージメント、取引通知、プロモーションオファーのために、市場に属する製品を活用している。